

民生证券股份有限公司

关于希荻微电子集团股份有限公司

部分募投项目调整投资规模

及延期的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“希荻微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目调整投资规模及延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日出具的《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 33.57 元，募集资金总额为 134,313.57 万元；扣除发行费用共计 12,172.72 万元后，募集资金净额为 122,140.85 万元，上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2022 年 1 月 17 日出具了普华永道中天验字(2022)第 0095 号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 截至2024/06/30投入金额 | 达到预定可使用状态日 |
|----|------|------|-----------|------------------|------------|
|----|------|------|-----------|------------------|------------|

| | | | | | 期 |
|-----------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 1 | 高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目 | 16,715.66 | 16,715.66 | 16,121.67 | 2024年10月 |
| 2 | 新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目 | 8,531.56 | 8,531.56 | 5,894.29 | 2024年10月 |
| 3 | 总部基地及前沿技术研发项目 | 23,921.79 | 23,921.79 | 1,795.50 | 2024年12月 |
| 4 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 不适用 |
| 合计 | | 58,169.01 | 58,169.01 | 32,811.47 | — |

注：上表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

具体详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-065）。

三、部分募投项目调整投资金额的情况和原因

（一）部分募投项目调整投资金额的情况

结合公司募投项目实施的具体情况，公司拟将总部基地及前沿技术研发项目中的研发费用3,902.13万元调整至高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目（以下简称“本次调整”），具体如下：

单位：万元

| 序号 | 募投项目名称 | 原定募集资金承诺投资总额 | 本次拟调整金额 | 本次调整后投资总额 |
|----|----------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目 | 16,715.66 | 3,902.13 | 20,617.79 |
| 2 | 总部基地及前沿技术研发项目 | 23,921.79 | -3,902.13 | 20,019.66 |

除了调减研发费用外，总部基地及前沿技术研发项目的其他内部投资结构均未发生变化，相关研发费用将调整至高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目，并全部用于研发费用。

（二）部分募投项目调整投资金额的原因

1. 本次调整将增加公司对高性能消费电子和通信设备电源管理芯片产品的研发投入，推动公司消费电子业务板块的持续快速发展

高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目的研发方向为消费

电子和通信设备领域的电源管理芯片产品，可应用于智能手机、笔记本电脑、TWS耳机、智能手表等终端设备。本项目旨在通过对电源管理芯片的进一步升级，横向拓展公司产品应用领域，提高公司整体竞争实力。截至2024年6月30日，公司高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目已投入募集资金16,121.67万元，投入进度为96.45%，已有多款锂电池充电芯片、高性能DC/DC芯片和端口保护芯片新品实现量产出货。尽管近年来受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突和行业周期性波动等多重因素影响，全球半导体市场进入周期性低迷时期，以智能手机、电脑为代表的消费电子市场景气度下降，但从中长期来看，行业低谷不可持续。2024年，随着下游人工智能、高性能运算、新能源汽车等领域需求增长，以及智能手机、个人计算机为代表的消费电子等市场需求逐渐回暖。国内外市场的结构性差异导致模拟芯片市场出现“阶梯式复苏”的情况，即消费电子类模拟芯片产品将先于工业、汽车市场复苏，国内模拟芯片市场则先于海外市场好转。据此，继续加大对本项目的研发投入，能更好地满足电源管理芯片下游消费电子类产品市场的庞大需求，不断提升公司的持续经营能力和盈利能力。

电源管理芯片要满足高稳定、高可靠、低功耗等要求，高端电源管理芯片研发难度较大，研发周期较长。为持续占领消费电子电源管理芯片市场，提升市场份额，推动公司业务的持续快速发展，公司拟增加高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目投资金额，加大产品的研发力度，实现在关键核心技术上的进一步提高，促进公司现有产品的拓展，为未来开发新产品提供支持，提高公司产品的竞争优势。

2.将前沿技术研发项目的投资金额投入到高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目，有利于提高募集资金的使用效率

公司的募投项目总部基地及前沿技术研发项目建设内容包括两部分：（1）在广东省佛山市建设总部基地，基地将划分为研发实验室、展厅以及各职能部门的办公区，从而解决公司当前办公和研发实验室场地紧缺的问题（以下简称“总部基地建设项目”）；（2）公司将开展前沿双向交流转直流技术的研发，主要方向包括初级调节、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化等，以及进一步发展无线充电电源芯片（以下简称“前沿技术研发项目”）。其中，前沿技术研发项目的研发方向为高性能AC/DC转换和无线充电相关技术。由于公司已使用自有资金基本完成该研发项目，

现经公司综合考虑外部市场变化情况，预计未来不会在该技术方向上增加研发投入。因此，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将前沿技术研发项目的投资金额 3,902.13 万元投入至更具有市场价值的募投项目高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目中。

四、部分募投项目延期的情况和原因

（一）部分募投项目延期的情况

结合公司募投项目实施的实际情况，公司拟对募投项目达到预定可使用状态日期予以调整，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 延期后达到预定可使用状态日期 |
|----|----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目 | 2024年10月 | 2025年10月 |
| 2 | 新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目 | 2024年10月 | 2026年4月 |
| 3 | 总部基地及前沿技术研发项目 | 2024年12月 | 2026年6月 |

（二）部分募投项目延期的原因

1.高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目

如上文所述，高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目原定募集资金承诺投资总额为 16,715.66 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，已投入募集资金 16,121.67 万元，投入进度为 96.45%，公司拟增加投入募集资金 3,902.13 万元。为确保新增的募集资金能够得到充分运用，根据在研项目进展和募集资金预计使用情况，经公司测算，拟将该项目达到预定可使用状态日期由 2024 年 10 月延长至 2025 年 10 月。

2.新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目

截至 2024 年 6 月 30 日，公司新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目已投入募集资金 5,894.29 万元，投入进度为 69.09%，公司已研发出车载智能高/低边开关芯片、车规级高性能升/降压转换芯片、IPM 马达驱动芯片等多款量产产品，研发管线 20 多款。该项目对应的产品主要是车规级芯片，相对于消费级芯片，车规级芯片由于应用场景的环境复杂，对于芯片本身的稳定性、可靠性、耐久性要求更高，产品研发过程中需要 Tier 1 和主机厂的配合和支持，此外，芯片研发完成后，还需通过

下游客户的严格测试和验证之后才能进入客户导入和量产阶段。因此，车规芯片产品相对消费级芯片的研发门槛更高，整体研发周期和销售周期较长。与此同时，近年来全球汽车产业的发展面临新的机遇与挑战，特别是 AI 和自动驾驶等技术的发展，对于芯片硬件底层功能和上层应用算法提出了更高要求。公司项目在研发推进过程中，也需兼顾市场动态、客户需求和前沿技术趋势等多方面的变化，持续对车规芯片产品的技术指标和性能参数进行迭代升级。

因此，由于项目在实际建设过程中受到项目实施进度、外部产业环境等因素影响，新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目完全达到预定可使用状态日期有所延后。在保证募投项目投资内容、投资总额、实施主体等不发生变化的情况下，公司拟将新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 4 月。

3.总部基地及前沿技术研发项目

截至 2024 年 6 月 30 日，总部基地及前沿技术研发项目投入募集资金 1,795.50 万元，投入进度为 7.51%。由于公司总部基地及前沿技术研发项目所在地块属于佛山市南海区的城市轨道交通安全保护区，所涉及政府规划、审批等前置必备程序较多及流程较长，导致该项目整体开展进度和募集资金投入较慢。根据相关法律和地方法规及规范性文件的规定，由于位于佛山市南海区的城市轨道交通安全保护区为建设项目，在申请总部基地建设项目的规划许可、施工许可前以及施工过程中，均需取得轨道交通主管部门或其行政委托单位的审查同意。公司取得相关土地的《不动产权证书》后，即积极办理总部基地建设项目的相关规划、报批手续，具体情况如下：

| 时间 | 事项 |
|------------|--|
| 2022/06/10 | 公司取得总部基地建设项目相关地块的《不动产权证书》（粤（2022）佛南不动产权第 0081786 号）。 |
| 2022/06/14 | 佛山市南海区铁路投资有限公司（以下简称“南海铁投”）出具《佛山市南海区铁路投资有限公司关于希荻大厦涉南海有轨电车 1 号轨道交通保护地质勘察钻探方案的复函》（南铁投函[2022]125 号），同意公司报审的希荻大厦涉南海有轨电车 1 号线轨道交通保护地质勘察钻探方案。 |
| 2023/02/14 | 公司取得佛山市自然资源局发放的《建设工程规划许可证》（建字第 440605202300155 号）。 |
| 2023/03/13 | 南海铁投出具《佛山市南海区铁路投资有限公司关于希荻大厦项目涉南海有轨电车 |

| 时间 | 事项 |
|------------|--|
| | 1 号线轨道交通保护规划方案的复函》(南铁投函[2023]71 号), 原则同意公司报审的希荻大厦涉南海有轨电车 1 号线轨道交通保护规划方案。 |
| 2023/10/09 | 南海铁投出具《佛山市南海区铁路投资有限公司关于希荻大厦项目涉南海有轨电车 1 号线轨道交通保护设计方案的复函》(南铁投函[2023]358 号), 原则同意公司报审的希荻大厦涉南海有轨电车 1 号线轨道交通保护设计方案。 |
| 2023/12/21 | 南海铁投出具《佛山市南海区铁路投资有限公司关于征询希荻大厦基坑支护施工方案涉南海有轨电车 1 号线轨道交通保护的复函》(南铁投函[2023]468 号), 原则同意公司报审的希荻大厦涉南海有轨电车 1 号线轨道交通施工方案。 |
| 2024/01/16 | 公司取得佛山市南海区住房和城乡建设局发放的《建筑工程施工许可证》(编号: 440605202401160501), 公司总部基地建设项目于 2024 年 1 月正式动工。 |

注: 公司总部基地建设项目提交相关政府部门办理规划、施工许可等报批手续的名称为“希荻大厦”。

公司于 2024 年 1 月取得总部基地建设项目的《建筑工程施工许可证》, 并正式开工建设。截至 2024 年 8 月 30 日, 公司正在进行总部基地建设项目的基坑和桩基础工程建设。根据建设工程的施工进度, 公司拟将总部基地及前沿技术研发项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 6 月。

尽管公司在积极推进总部基地建设项目的建设, 但如前所述, 公司总部基地建设项目涉及的外部审批程序繁复, 即便公司已对该项目的达到预定可使用状态日期进行调整, 在项目实施过程中, 仍可能存在各种不可预见因素, 导致达到预定可使用状态日期具有不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

五、本次部分募投项目调整投资规模及延期对公司的影响

本次部分募投项目调整投资规模及延期事项是根据募投项目实施情况作出的审慎决定, 符合公司发展战略, 有利于公司优化资源配置, 提高募集资金的使用效率, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。公司将继续严格遵守有关募集资金使用的相关规定, 加强募集资金使用的监督, 确保募集资金使用的合法、有效。

六、专项意见说明

(一) 董事会意见

公司于 2024 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于

部分募投项目调整投资规模及延期的议案》，同意公司对部分募投项目调整投资规模及延期。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模及延期的议案》。监事会认为：本次部分募投项目调整投资规模及延期事项是公司根据募投项目实施情况作出的审慎决定，符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。监事会同意本次部分募投项目调整投资规模及延期事项。

七、保荐机构核查意见

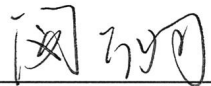
经核查，本保荐机构认为：

公司本次部分募投项目调整投资规模及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求。公司本次部分募投项目调整投资规模及延期事项是根据募投项目实施情况作出的审慎决定，符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。

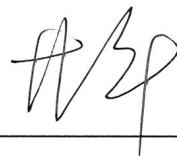
综上，本保荐机构对公司本次部分募投项目调整投资规模及延期事项无异议。

(以下无正文，为《民生证券股份有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司部分募投项目调整投资规模及延期的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



闫 翊



黄 平

